

HALBJAHRESBERICHT
01. JANUAR - 30. JUNI 2003

KENNZAHLEN Q2/2003

Millionen Euro	Q2/2003	Q1/2003	1.HJ/2003	1.HJ/2002
Auftragseingang netto	25,0	25,3	50,3	53,5
Auftragsbestand netto	–	38,5	40,7	52,6
Nettoumsatz	21,6	17,6	39,2	56,4
Eigenkapital	–	111,8	108,2	121,6
Eigenkapitalquote	–	69,4%	69,5%	66,5%
Net Cash	–	16,7	18,5	13,4
Free Cash Flow	2,5	4,6	7,1	3,3
Rohertrag	9,5	4,7	14,2	24,5
Rohertragsmarge	44,0%	27,0%	36,3%	43,3%
EBITDA	-2,7	-7,5	-10,2	-6,5
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-3,0	-5,8	-8,8	-6,0
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,20	-0,39	-0,59	-0,41
Mitarbeiter (Anzahl)	727	756	727	969

Editorial	4
Das 2. Quartal 2003 im Überblick	7
Mit „SupraYield™“ Wettbewerbsvorteile gesichert	7
Hauptversammlung erfolgreich verlaufen	9
Einzigartige Software für Testverfahren entwickelt	10
Erneut Bestnoten bei VLSI-Kundenumfrage erzielt	11
Umsatz und Auftragslage	12
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	12
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	13
Finanzbericht	14
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	14
Konzernbilanz	16
Konzernkapitalflussrechnung	18
Konzerneigenkapitalentwicklung	20
Rechnungslegungsgrundsätze / Segmentberichterstattung	20
Aktien und Bezugsrechte der Organe	22
Unternehmenskalender	22



Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

die optimistischeren Stimmen zur konjunkturellen Entwicklung 2003 mehrten sich in den vergangenen drei Monaten. Eine neue, positivere Grundstimmung macht sich breit, die auch in unserer Branche zu spüren ist. Große Chiphersteller wie Intel, Infineon oder Texas Instruments geben einen leichten Aufwärtstrend zu erkennen, und in der Branche wird wieder über eine Ausweitung von Produktionskapazitäten diskutiert.

Auch für unsere Geschäftsentwicklung gilt: Wir sind wieder optimistischer. Im abgelaufenen zweiten Quartal erreichte SÜSS MicroTec trotz der erneut ungünstigeren Währungsentwicklung einen Auftragseingang von 25,0 Mio. Euro und kann so an die erfreulichere Entwicklung vom ersten Quartal 2003 (25,3 Mio. Euro) anknüpfen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging der Auftragseingang um 16% zurück. Allerdings ergibt sich unter Verwendung gleicher Wechselkurse für das erste Halbjahr 2003 ein um knapp 4% gesteigerter Auftragseingang.

Die Umsatzentwicklung zeigte in den letzten drei Monaten eine leicht steigende Tendenz: Der Umsatz liegt bei 21,6 Mio. Euro und konnte sich so etwas von der Entwicklung im ersten Quartal abkoppeln. Entsprechend verbesserten sich auch das Ergebnis vor Steuern (-4,6 Mio. Euro) und die Rohertragsmarge. Sie erreichte im zweiten Quartal 43,8%. Positiv entwickelte sich aus unserer Sicht im zweiten Quartal der Free Cash Flow. Mit 2,5 Mio. Euro lag dieser erneut im Plus (Q1: 4,6 Mio. Euro). In der Geschäftsentwicklung des zweiten Quartals zeigten sich weiterhin deutlich die Erfolge der nunmehr abgeschlossenen, umfassenden Restrukturierung von SÜSS MicroTec. Zum Stichtag 30. Juni 2003 gehörten 727 Mitarbeiter der Gruppe an.

Im abgelaufenen Quartal stand insbesondere der Geschäftsbereich Forschung & Entwicklung im Mittelpunkt: Ende Juni führten wir mit der „SupraYield“-Technologie ein neues Produkt ein, mit dem unsere Kunden ihre Herstellungskosten weiter senken (s. S. 7). Damit treffen wir genau den Puls der Zeit: Kostensenkung ist und bleibt im Rahmen der Chipproduktion wesentliches Thema unserer Kunden – und der gesamten Branche. Mit „SupraYield“ treiben wir die Entwicklung zukunftsweisender Technologien für die Halbleiterindustrie weiter voran – eine Aufgabe, die für uns auch künftig größte Bedeutung hat.

Mit dem internationalen Konsortium SECAP erzielten wir im Technologiebereich ebenfalls bedeutende Fortschritte: Auf der im vergangenen Jahr installierten 300mm-Produktionslinie für Advanced Packaging-Prozesse bei Unitive, Inc., in Taiwan, finden bereits Testläufe für Kunden statt – die Rückmeldungen der Kunden sind dabei sehr positiv. So berichtete Unitive, Inc. im Juli auf der Halbleiter-Equipment-Messe SEMICON West öffentlich über die ersten Erfahrungen mit der 300mm-Linie nach ihrer kompletten Installation. Danach hat die 300mm-Anlage selbst die hochgesteckten Erwartungen von Unitive deutlich übertroffen und in nahezu allen Spezifikationen gleiche oder bessere Werte gezeigt, als die bereits vom Markt durchgehend akzeptierten 200mm-Systeme. Wir sind deshalb optimistisch, dass mittelfristig Kunden ihre 300mm-Produktion auf der SECAP-Linie aufnehmen – ein wichtiger Meilenstein für den Durchbruch des Zukunftsmarkts Advanced Packaging.

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner von SÜSS MicroTec, das zweite Quartal 2003 zeigte sich auch im Hinblick auf die Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie erfreulicher. Unsere Aktie weist nach langer „Durststrecke“ wieder eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung auf. Für das laufende dritte Quartal erwarten wir, dass sich die Erholungstendenz in der Halbleiterbranche weiter fortsetzt. Entsprechende Signale gab es auch auf der weltweit größten Halbleitermesse, SEMICON West, in San Francisco. In Bezug auf Anzahl und Aktualität der diskutierten Projekte kann diese SEMICON West-Messe als eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre angesehen werden. Vor allem im Bereich des Packaging wird eine Erholung erwartet, die zeitlich noch vor einer Belebung in der allgemeinen Halbleiter-Equipment-Industrie in 2004 liegt.

Garching, im August 2003



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak
Vorstand Finanzen

Mit „SupraYield™“ Wettbewerbsvorteile gesichert

Mit der neuen „SupraYield“-Technologie treibt SÜSS MicroTec sein Wachstum in den wichtigen Märkten Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter entscheidend voran. Gleichzeitig erfüllt das Garchingener Unternehmen mit „SupraYield“ die aktuellen und steigenden Anforderungen der Halbleiterbranche nach hochwertigen, effizienten und dabei kostengünstigen Technologien.

„SupraYield“ ist eine neue Technologie für die Mask Aligner, der wichtigsten Produktgruppe von SÜSS MicroTec. Mit „SupraYield“ ausgerüstete Mask Aligner bieten den Kunden maßgebliche Wettbewerbsvorteile:

- eine **Strukturauflösung** bei der Wafer-Vollfeldbelichtung von bis zu unter einem Mikrometer (bisheriger Standard etwa 5 Mikrometer) verbunden mit einer genaueren Abbildung sowie besseren Übertragung von Strukturen,
- bis zu 60% **geringere Kosten** für die Photolithografie und damit einen deutlichen Kostenvorsprung vom Mask Aligner im Vergleich zur Stepper-Technologie sowie
- eine deutlich **höhere Ausbeute** (Yield) funktionsfähiger Chips am Ende des Chipherstellungsprozesses.

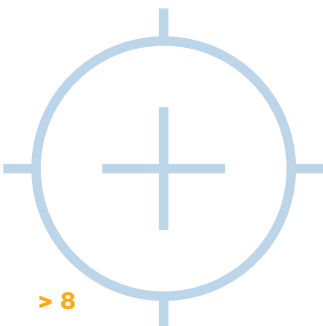
Die „SupraYield“-Technologie fokussiert somit das zentrale Thema bei der Chipherstellung: Denn der Yield – die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer – ist bei jeder Chipherstellung entscheidend. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden. Ziel der neuen „SupraYield“-Technologie ist deshalb, den Yield weiter nach oben zu treiben und die Chipproduktion für den Kunden so zu optimieren.

In der Praxis zeigt sich eines der wesentlichen Elemente von „SupraYield“ wie folgt: Für den Lithografieprozess wird die Photomaske der Mask Aligner mit einer äußerst dünnen teflonartigen Schutzschicht überzogen – vom Prinzip her ähnlich wie bei einer Teflon-Pfanne. Dadurch ist

sie unempfindlich bei Berührungen mit dem Siliziumwafer. So kann der Mask Aligner die Lithografie in extrem kleinen Abstand zwischen Photo- maske und Wafer bis hin zur Kontaktbelichtung durchführen, was die Übertragungsqualität der Submikrometerstrukturen erheblich verbessert. Durch den Schutzfilm der Photomaske bleiben dabei keine Photo- resist-Ablagerungen an der Maske zurück; ihre Lebensdauer verlängert sich deutlich. Somit steigt durch den Einsatz von „SupraYield“ die Effizienz und Qualität des Lithografieprozesses erheblich.

„SupraYield“ kann in allen Anwendungsfeldern mit Strukturierungsanforderungen von unter 10 Mikrometern bis hinunter zu 0,8 Mikrometer eingesetzt werden. In dieses Spektrum fallen alle Anwendungen des Advanced Packaging – einschließlich der aggressivsten Road Map-Ziele für das sogenannte „Gold Bumping“ – sowie die meisten Anwendungen in der Mikrosystemtechnik und viele Verbindungshalbleiter-Verfahren.

„SupraYield“ erlaubt den Einsatz der kostengünstigen Mask Aligner-Technologie damit jetzt auch in Strukturauflösungsbereichen, die bisher aufgrund des besseren Yields den Steppern vorbehalten waren. Gerade in Zeiten der Kostendämpfung und Budgetreduzierung bei unseren Kunden ist diese neue Technologie ein wesentliches Element zur Ausweitung unserer potenziellen Märkte, unseres Marktanteils und damit unserer Geschäftstätigkeit.



Hauptversammlung erfolgreich verlaufen

Mit Erfolg führte die SÜSS MicroTec AG am 6. Juni 2003 ihre Hauptversammlung durch: Alle Tagesordnungspunkte wurden mit mindestens 99,99% der Stimmen beschlossen. Insgesamt vertraten die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre 34,02% des Grundkapitals – das entspricht 5.088.462 von 14.956.884 Stückaktien. Im Einzelnen gab es folgende Abstimmungsergebnisse zu den anstehenden Beschlüssen:

- Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Zustimmung: 99,99%
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung: 99,99%
- Bestellung PriceWaterhouseCoopers GmbH als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
Zustimmung: 99,99%
- Durchführung von Satzungsänderungen
Zustimmung: 100%
- Neuwahl des bisherigen Aufsichtsrats
Zustimmung: 99,99%
- Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags zwischen SÜSS MicroTec AG und SÜSS MicroTec Lithography GmbH
Zustimmung: 100%

Im Rahmen von Top 1 der Tagesordnung – der Vorlage vom Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2002 – erläuterte der Vorstand die Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung, das umfangreiche Restrukturierungsprogramm sowie die Kursentwicklung in 2002. Nach dem Geschäftsjahr 2002, als Jahr der Konsolidierung und Restrukturierung, sei SÜSS MicroTec – etwa durch positive Liquiditätsentwicklung und auch durch die neue, vielversprechende „SupraYield“-Technologie (vgl. auch S. 7) – sehr gut und zukunftsfähig aufgestellt.

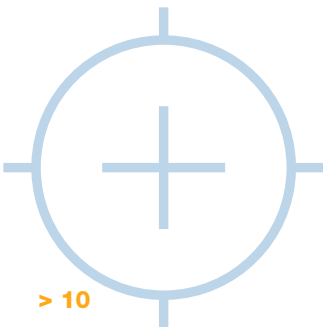
Weitere Informationen zum Bericht des Vorstands auf der Hauptversammlung 2003 erhalten Sie unter: [www.suss.de/Investor Relations/Hauptversammlung/ Downloads](http://www.suss.de/Investor%20Relations/Hauptversammlung/Downloads).

Einzigartige Software für Testverfahren entwickelt

SÜSS MicroTec erweitert sein Produktportfolio im Bereich Test & Measurement durch eine technische Innovation: Mit einer neu entwickelten Kalibrierungssoftware können Messungen im Hochfrequenzbereich jetzt so effektiv und qualitativ hochwertig wie nie zuvor durchgeführt werden – so bestätigen es aktuelle Untersuchungen unabhängiger Forschungsinstitute. Unter Kalibrierung ist dabei die genaue Abstimmung der Software auf das spezifische Prüfsystem zu verstehen. Die neue Software (SussCal 5.1) wird für Tests von Hochfrequenztechnik bis 110 Gigahertz wie etwa bei Bauelementen für Handys und Satelliten eingesetzt.

Je höher die Frequenz, desto größer die Anforderungen an das Test-Equipment: Per Kalibrierung werden deshalb die Störfaktoren wie Kabelbiegungen oder schlechte Verbindungen in der Messumgebung isoliert, um den anschließenden hochgenauen analytischen Test der Chips zu ermöglichen. Eine genaue Kalibrierung ist Voraussetzung für die erfolgreiche Überprüfung der Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Funktionsfähigkeit von Chipstrukturen in der Hochfrequenztechnik. Ohne vorherige Kalibrierung würden die Störfaktoren in die Messung einkalkuliert. Das bedeutet: Die Messung ist nicht zuverlässig.

Durch die Entwicklung der Kalibrierungssoftware optimiert SÜSS MicroTec seine hochwertigen Testverfahren weiter. Gleichzeitig sichert die technische Innovation SÜSS MicroTec einen Wettbewerbsvorteil im wichtigen Hochfrequenzmarkt, der aktuell rund 35% des Gesamtmarkts Test & Measurement ausmacht.



Erneut Bestnoten bei VLSI-Kundenumfrage erzielt

SÜSS MicroTec bietet seinen Kunden 2003 weiterhin einen erstklassigen Standard im Bereich Service und Support. Das ergaben im laufenden Jahr Umfrageergebnisse des namhaften, auf die Halbleiterbranche spezialisierten Marktforschungsinstituts VLSI Research (www.vlsi-research.com).

Bei der jährlichen VLSI Research-Umfrage zur Kundenzufriedenheit mit Equipment-Lieferanten („10 Best Annual Customer Satisfaction Survey on Chip Making Equipment Suppliers“) erzielte SÜSS MicroTec gleich in vier Kategorien Spitzenplätze unter den Top 10. Damit schließt SÜSS MicroTec an das hervorragende Ergebnis vom Vorjahr an und gehört bereits im zehnten Jahr in Folge zu den Halbleiterunternehmen mit der größten Kundenzufriedenheit.

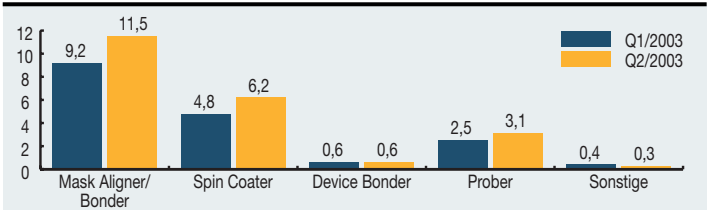
Den 2. Platz sicherte sich SÜSS MicroTec in der Kategorie „Small Suppliers of Wafer Processing Equipment“; Rang 4 im Bereich „Test & Material Handling Equipment“. In der Kategorie „Assembly Equipment“ erreichte SÜSS MicroTec Platz 5 und Rang 10 belegten wir in der erst 2002 eingeführten Kategorie „Focused Suppliers of Chip Making Equipment“ – mit deutlichem Vorsprung vor den direkten Wettbewerbern.

Im Rahmen der Umfrage versendete VLSI Research weltweit rund 43.000 Fragebögen an Entscheidungsträger in Halbleiterunternehmen, die in über 10 Kategorien um eine Einstufung ihrer Zulieferer gebeten wurden. Die Bewertung der einzelnen Zulieferer gilt als exemplarisch für die Kunden-Lieferanten-Beziehungen in der Halbleiterbranche.

Der Gesamtumsatz von 21,6 Mio. Euro in Q2/2003 bzw. von 39,2 Mio. Euro im 1. HJ/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

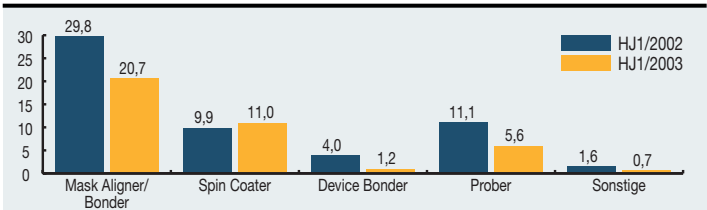
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



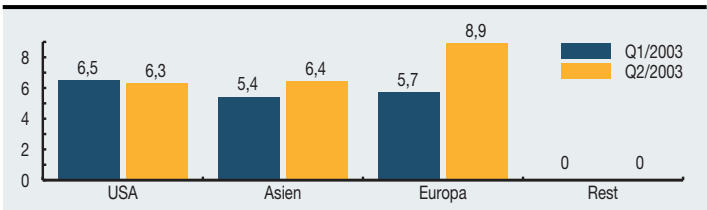
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



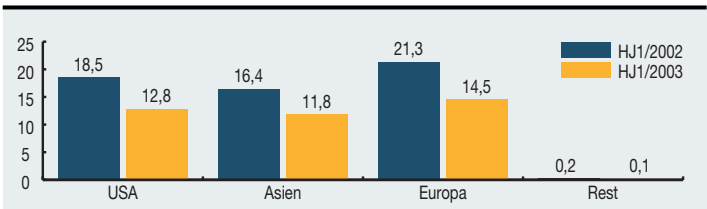
Umsatzentwicklung nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Umsatzentwicklung nach Regionen (Halbjahre)

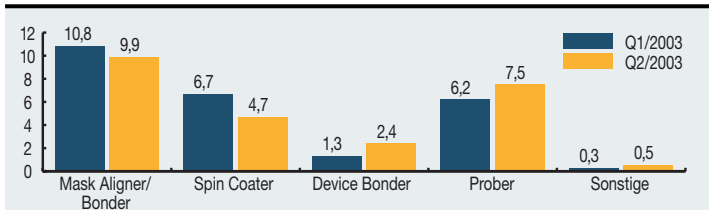
Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Der Auftragseingang von 25,0 Mio. Euro in Q2/2003 bzw. von 50,3 Mio. Euro im 1. HJ/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

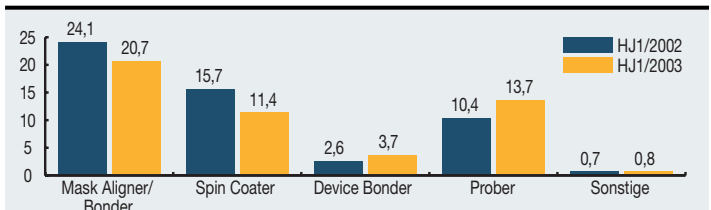
Auftragseingang nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



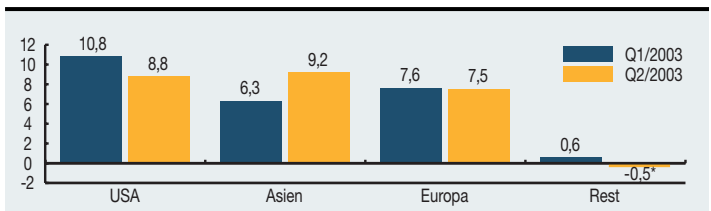
Auftragseingang nach Produktlinien (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Auftragseingang nach Regionen (Quartale)

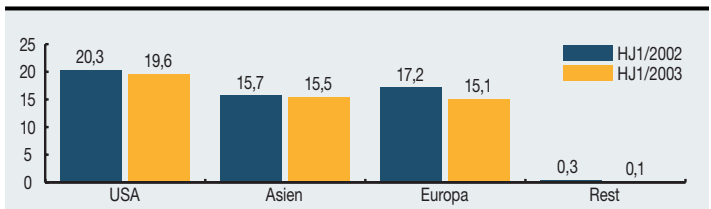
Angaben im Vergleich in Mio. Euro



*Umgliederung

Auftragseingang nach Regionen (Halbjahre)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



SÜSS MicroTec AG

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	01.04.2002- 30.06.2002*
Umsatzerlöse	28.371
Frachtkosten und Provisionen	-887
Umsatzerlöse netto	27.484
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	15.832
Bruttoergebnis vom Umsatz	11.652
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten	-12.393
Forschungs- und Entwicklungskosten	-3.241
Abschreibung des Firmenwerts	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	-237
Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung	-2.027
Operatives Ergebnis	-6.246
Zinsaufwendungen	-294
Zinserträge	109
Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis	0
Ergebnis vor Steuern	-6.431
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.333
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-4.098
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*	-6.246
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*	-4.641
Pro Aktie:	
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,27
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,27
Überleitung zum Comprehensive Income	-4.098
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	
Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern	
Fremdwährungsdifferenzen	-2.179
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung	0
Comprehensive Income	-6.277

* ungeprüft

01.01.2002- 30.06.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.04.2003- 30.06.2003*	01.01.2003- 30.06.2003*
58.634	132.379	22.184	40.465
-2.222	-4.864	-589	-1.291
56.412	127.515	21.595	39.174
31.958	79.598	12.137	24.969
24.454	47.917	9.458	14.205
-26.740	-48.006	-10.808	-21.322
-6.202	-12.537	-2.482	-4.918
0	0	0	0
925	-401	650	624
-2.005	-3.319	-1.053	-2.029
-9.568	-16.346	-4.235	-13.440
-652	-1.309	-412	-625
283	479	118	179
0	6	-30	-22
-9.937	-17.170	-4.559	-13.908
3.897	8.232	1.563	5.103
-6.040	-8.938	-2.996	-8.805
-9.568	-16.340	-4.265	-13.462
-6.502	-9.535	-2.655	-10.170
-0,41	-0,60	-0,20	-0,59
-0,41	-0,60	-0,20	-0,59
-6.040	-8.938	-2.996	-8.805
-1.898	-3.192	-728	-1.840
0	-42	0	0
-7.938	-12.172	-3.724	-10.645

SÜSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ

TEUR	30.06.2002*	31.12.2002	30.06.2003*
AKTIVA			
Flüssige Mittel	19.559	16.914	21.548
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	26.905	34.105	17.433
Sonstige kurzfristige Forderungen	4.463	9.249	6.114
Vorräte, netto	61.465	48.062	46.433
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	723	958	674
Kurzfristige aktive latente Steuern	7.313	3.405	3.827
Summe Umlaufvermögen	120.428	112.693	96.029
Sachanlagen	18.699	16.592	14.323
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.825	9.679	8.423
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	142	148	148
Langfristige aktive latente Steuern	968	4.895	6.809
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	2.753	1.940	2.021
Summe Aktiva	182.824	173.956	155.762

* ungeprüft

TEUR	30.06.2002*	31.12.2002	30.06.2003*
PASSIVA			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	6.114	3.531	3.098
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	616	275	150
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.197	3.934	3.979
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	470	223	223
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.677	3.546	3.440
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	28.745	24.432	19.034
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	45.819	35.941	29.924
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	10.010	14.501	12.801
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	629	613	549
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.477	3.580	3.622
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.287	735	615
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	0	52	52
Summe langfristige Verbindlichkeiten	15.403	19.481	17.639
Gezeichnetes Kapital / Genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2002 und 30.06.2003); davon ausgegeben (in tsd.) 14.957 (31.12.2002 und 30.06.2003)	14.957	14.957	14.957
Kapitalrücklage	79.745	80.911	81.221
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	28.535	25.637	16.832
Kumuliertes Other Comprehensive Income	-2.068	-3.404	-5.244
Summe Eigenkapital	121.602	118.534	108.199
Summe Passiva	182.824	173.956	155.762

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 30.06.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 30.06.2003*
Mittelzufluss aus der laufenden			
Geschäftstätigkeit			
Jahresfehlbetrag	-6.040	-8.938	-8.805
Wechselkursbedingte Veränderung des Eigenkapitals	-535	-1.505	-984
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages/ -überschusses zum Mittelzufluss aus der lfd.			
Geschäftstätigkeit			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	575	1.430	310
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung	0	514	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.150	2.200	956
Abschreibung auf den Goodwill	0	0	0
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	0	106	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	1.681	4.174	2.126
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	202	547	210
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-2.537	-2.556	-2.336
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	-76	-20	32
Gewinn aus Beteiligungen	0	-1	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	174	-167	34
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	1.437	811	1.266
Veränderungen von Aktiva und Passiva			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.725	16.866	16.638
Veränderung der Vorräte	-1.842	15.047	363
Veränderung des aktiven Rechnungsab- grenzungspostens	335	100	284
Veränderung der sonstigen Aktiva	-1.922	-5.895	3.054
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.280	-3.543	45
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-5.793	-10.106	-5.398
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	-99	-243	42
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-2.221	-2.721	-120
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.934	6.100	7.717

* ungeprüft

TEUR	01.01.2002- 30.06.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 30.06.2003*
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.448	-2.935	-613
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.414	-139	-42
Auszahlungen für Unternehmenserwerb	0	-3.356	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	200	203	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.662	-6.227	-655
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Bankdarlehen	0	5.677	0
Tilgung von Bankdarlehen	-1.349	-2.666	-1.806
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-23.408	-25.991	-433
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-24	-844	-189
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	33.609	34.465	0
Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten	0	317	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-1.376	0
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.828	9.582	-2.428
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes			
Finanzmittelbestandes	12.100	9.455	4.634
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	639	-239	-659
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	6.820	7.698	17.573
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	19.559	16.914	21.548
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung			
Zinszahlungen während der Periode	694	1.103	577
Einkommensteuererstattungen/-zahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen	5.409	3.304	1917
Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten			
Zugang zum Finanzierungsleasing	247	710	31

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNEIGENKAPITALENTWICKLUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2002	13.802	13.802
Zuführung aufgrund Kapitalerhöhung	1.130	1.130
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Zuführung aufgrund Ausübung von Bezugsrechten	25	25
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 30.06.2002	14.957	14.957
Stand 01.01.2003	14.957	14.957
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 30.06.2003	14.957	14.957

Rechnungslegungsgrundsätze

Die dargestellten Angaben zum Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG entsprechen den Vorschriften der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles („US-GAAP“). Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2003 wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2002 zugrunde lagen und im Anhang ausführlich erläutert wurden.

Segmentberichterstattung

Die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen sind lediglich in einem Segment tätig. Eine Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Segmente entfällt aus diesem Grund.

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
46.716	433	34.575	-170	95.356
32.162				33.292
575				575
292				317
		-6.040		-6.040
			-1.898	-1.898
79.745	433	28.535	-2.068	121.602
80.911	433	25.637	-3.404	118.534
310				310
		-8.805		-8.805
			-1.840	-1.840
81.221	433	16.832	-5.244	108.199

SÜSS MicroTec AG

AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE UNTERNEHMENSKALENDER

Aktien und Bezugsrechte der Organe	31.12.2002		30.06.2003	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Vorstand				
Dr. Richter	400.000	65.000	400.000	105.000
S. Schulak	0	286	0	40.286
Aufsichtsrat				
Dr. Süß (Vors.)	1.039.780	0	1.104.780	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Prof. Dr. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0
H. Görtz	3.894	0	3.894	0

Unternehmenskalender 2003

02.09.	SCC – Small Cap Conference, Frankfurt a. M.
15.09.-17.09.	SEMICON Taiwan, Taipei
04.11.	Neunmonatsbericht 2003
03.12.-05.12.	SEMICON Japan, Chiba

SÜSS MicroTec AG

Schleissheimer Straße 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-0

Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: ir@suss.de

www.suss.de